

平成29年3月期 第2四半期
決算説明会

英知をつなげる エレクトロニクスの会社

平成28年11月1日
ヒロセ電機株式会社

注意事項

本資料には、ヒロセ電機の現時点における予測に基づく記述が含まれています。

これら将来に関する記述は、既知または未知のリスク及び不確実性その他の要因が内在しており、当社における実際の業績と異なる恐れがあります。ご承知おき下さい。

H28年度第2四半期のビジネス概況

[H28年度第1四半期 (4月～6月)]

◎スマートフォン市場向け受注は、中国市場向け等が予想をやや上回り、順調に推移した。自動車市場向けは安定して推移。産機市場向け売上は今期前半が弱かったが、後半より上向き傾向となった。

[H28年度第2四半期 (7月～9月)]

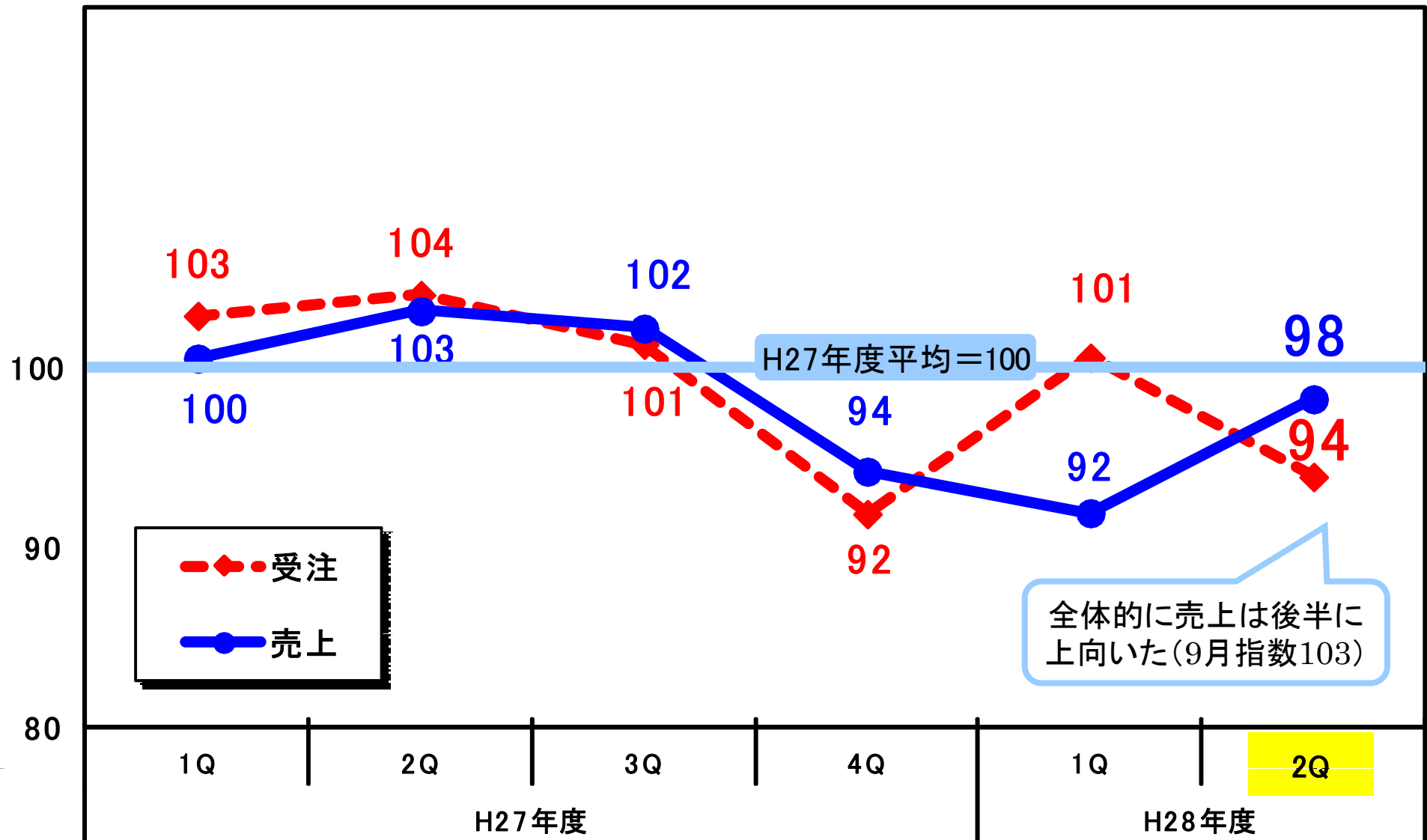
◎全体売上では1Q対比で増加。スマートフォン市場向けは中国市場向け等を中心に好調に推移。自動車市場向けは海外向けは低調だったものの、国内向けは好調。産機市場向けは若干のプラスとなった。

◎H28年度第2四半期受注対前年同期比 -9.7% (対H28年度第1四半期比 -6.6%)、売上対前年同期比 -4.7% (対H28年度第1四半期比 +6.9%)で着地。

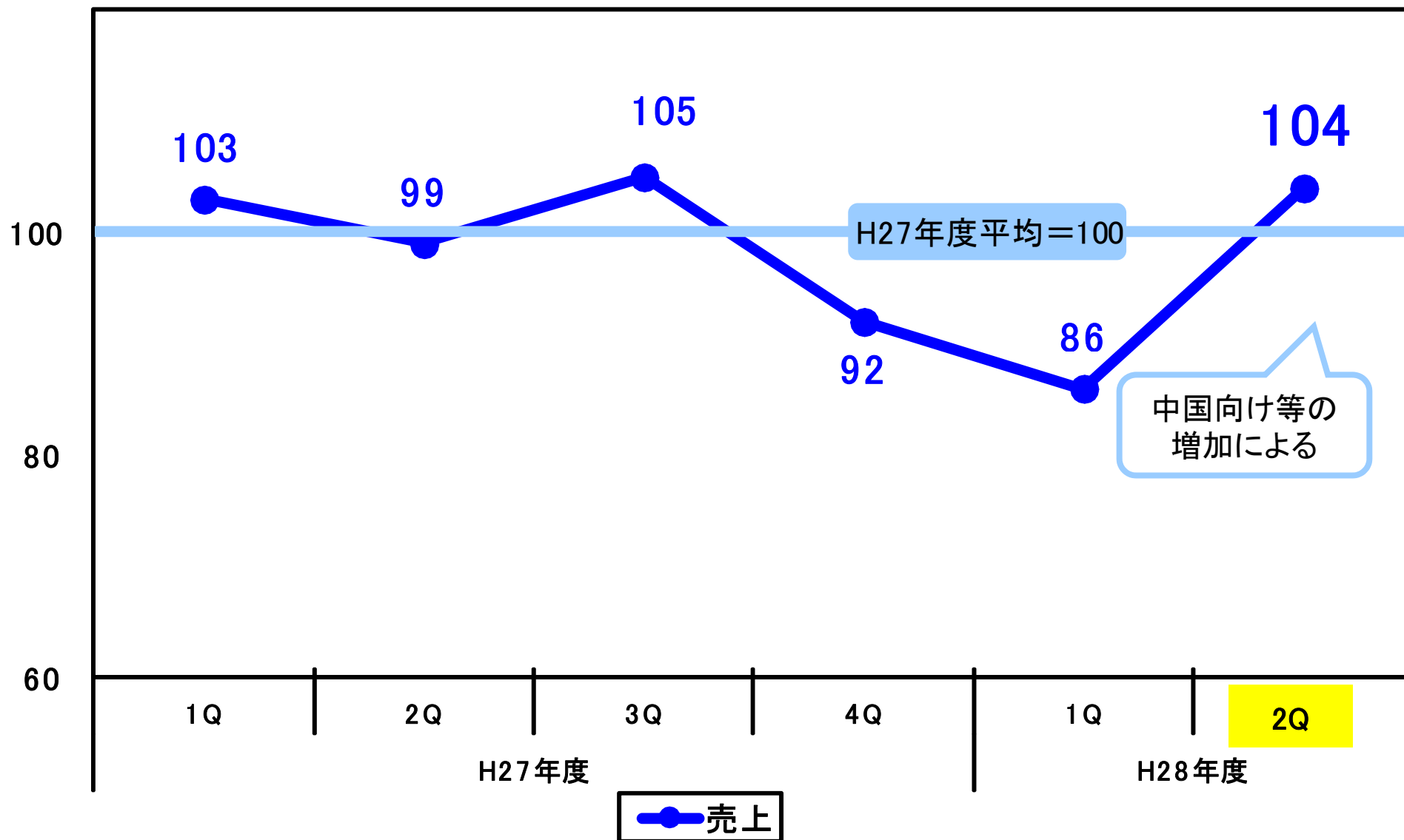
[H28年度第2四半期累計 (4月～9月)]

◎H28年度第2四半期累計受注 584.7億円 (対前年同期比 -6.0%)、売上 571.8億円 (対前年同期比 -6.6%)、経常利益 143.6億円 (利益率 25.1%、対前年同期比 -14.2%)。

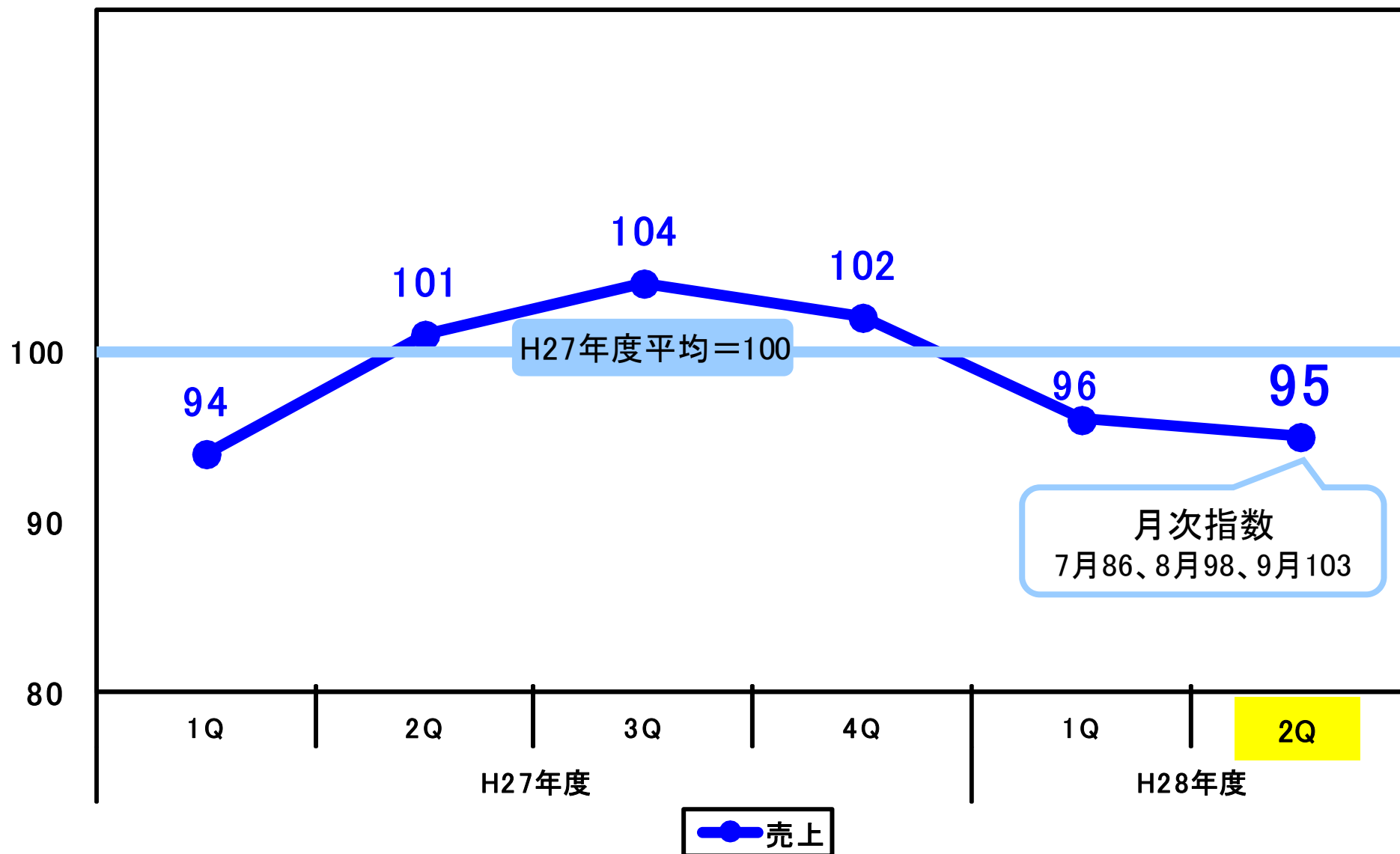
全体



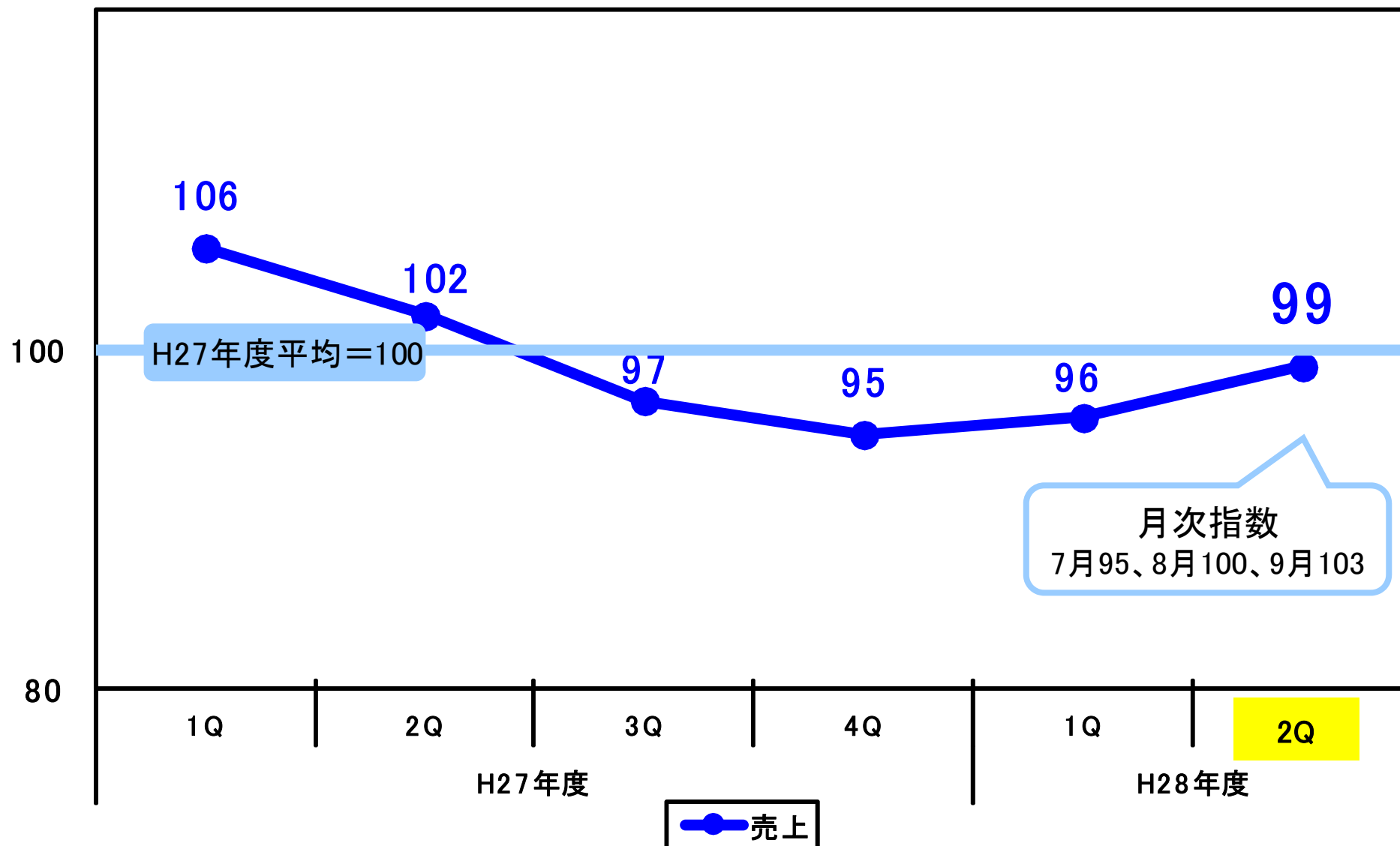
スマートフォン・携帯電話



自動車



一般産機(電子応用、FA制御、その他)



H28年度第2四半期 連結決算概要

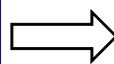
注) 緑色斜体数値・・・H28/4公表数値

(金額単位: 億円)

	(A) H27年度 第2四半期	(B) H28年度 第2四半期	(B)-(A)	(B)/(A)
売上高 (売上原価率) (販売・管理費比率)	612.3 (53.9%) (21.2%)	571.8 (53.4%) (21.6%)	-40.5 (-0.5%) (+0.4%)	-6.6%
営業利益 (%)	152.6 24.9%	142.9 25.0%	-9.7 (+0.1%)	-6.3%
経常利益 (%)	167.4 27.3%	143.6 25.1%	-23.8 (-2.2%)	-14.2%
当期利益 (%)	116.9 19.1%	101.3 17.7%	-15.6 (-1.4%)	-13.4%
総資産残高	3,227.4	3,162.9	-64.4	-2.0%
自己資本比率	90.3%	90.0%		
一株当り当期利益	328.50円	289.69円		

対前年同期主要増減	
[売上高]	40.5億円減
比0中単体	子会社
-26.4億円	-14.1億円
[売上原価率]	0.5ポイント良化
仕入原価費率	37.5% → 39.3%
減価償却費率	6.3% → 4.4%
労務費率	5.8% → 5.5%
[販売・管理費比率]	0.4ポイント悪化
費用減(-6.4億減)なるも売上減の為	
[営業外損益]	
為替差損益	+7.2億円 → -5.8億円
※減価償却方法変更(定率法→定額法)及び一部耐用年数変更に伴う営業利益・経常利益影響額(損益増加額)	
	12.9億円

為替レート: US\$	121.80円	105.29円
為替レート: €	135.07円	118.15円
為替レート: 100ウォン	10.77円	9.23円

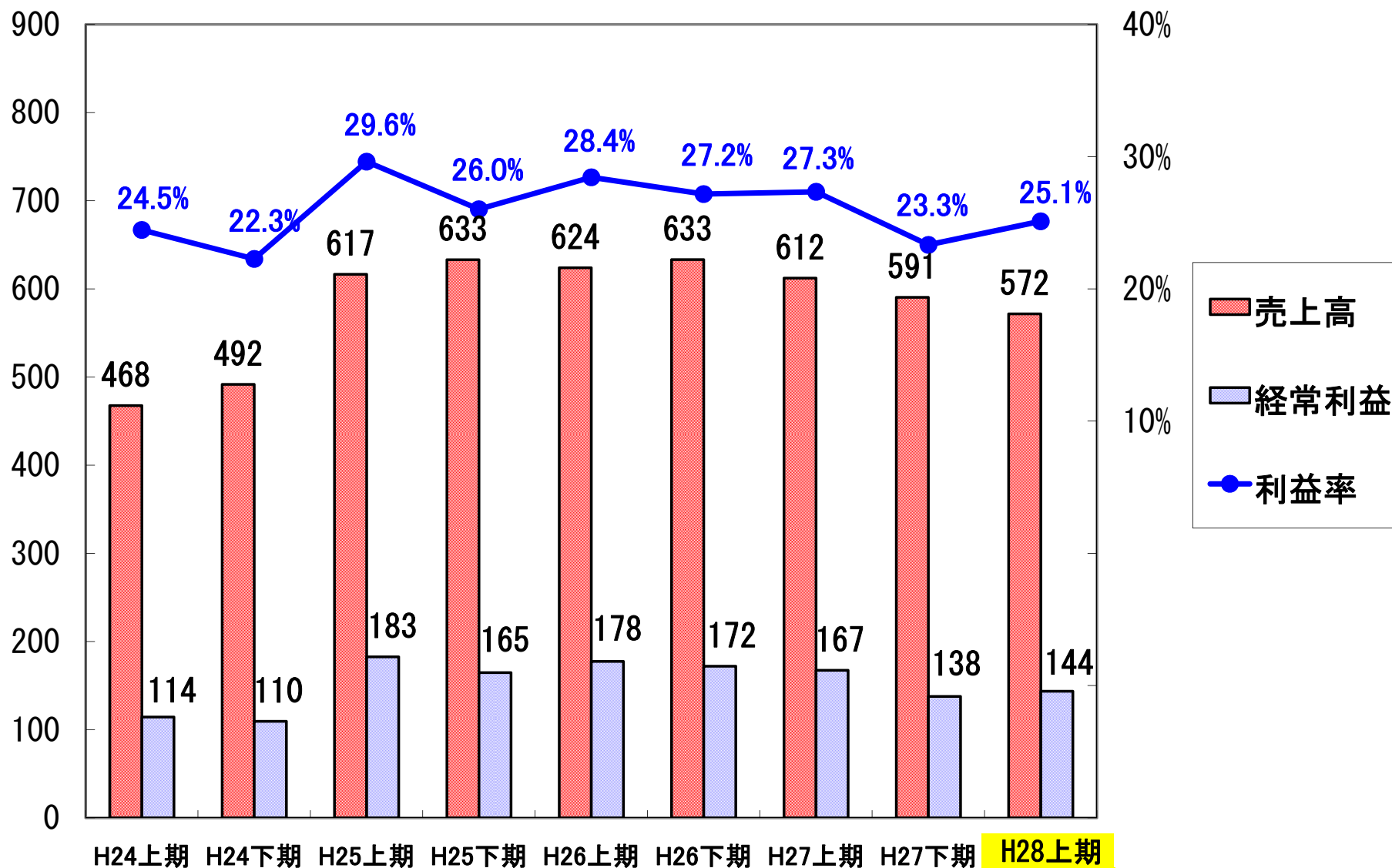


(単位: 億円)

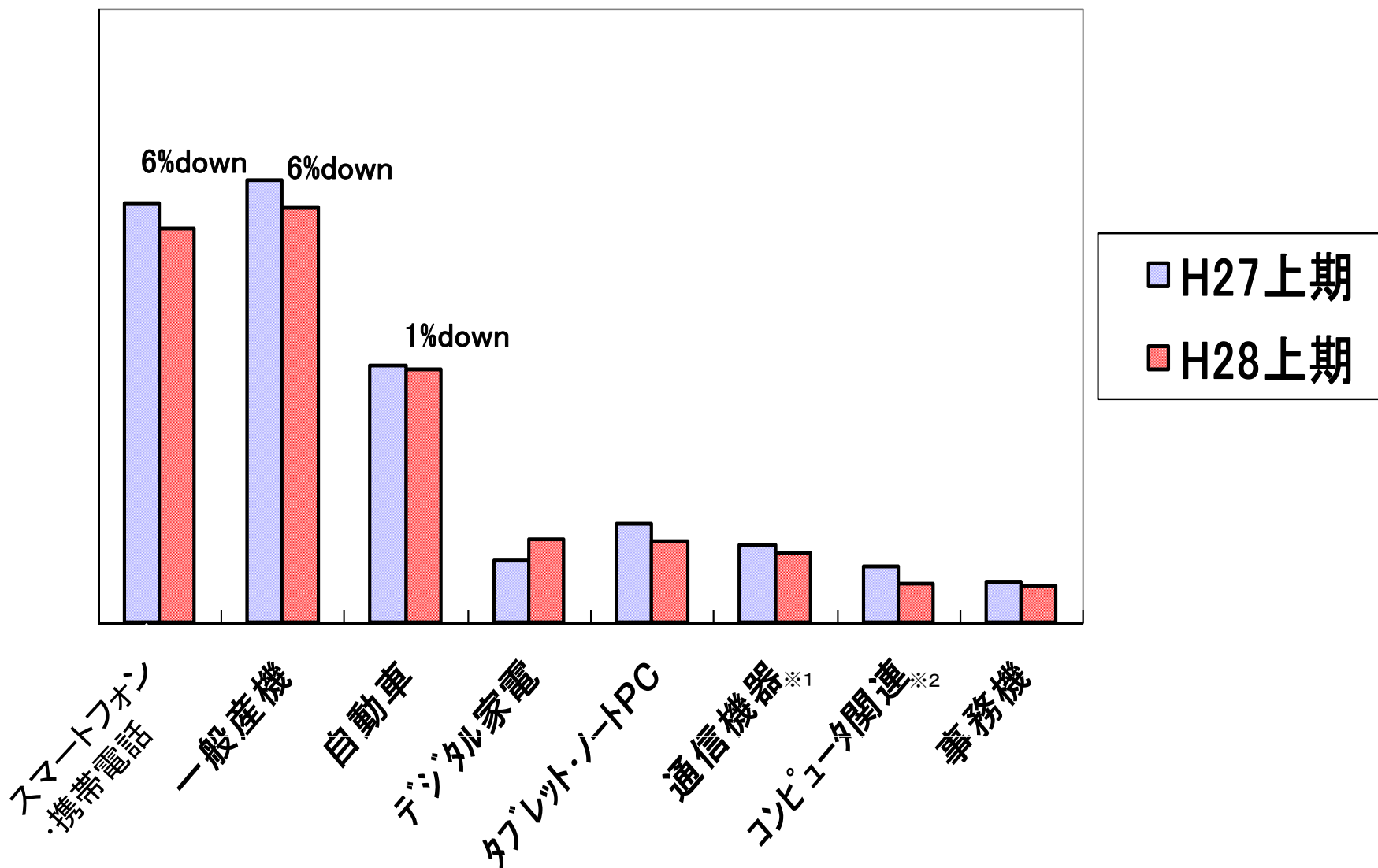
対前年同期為替影響額	
売上高	-65.0
営業利益	-32.6
経常利益	-47.0

半期別 売上高・利益 推移

(億円)



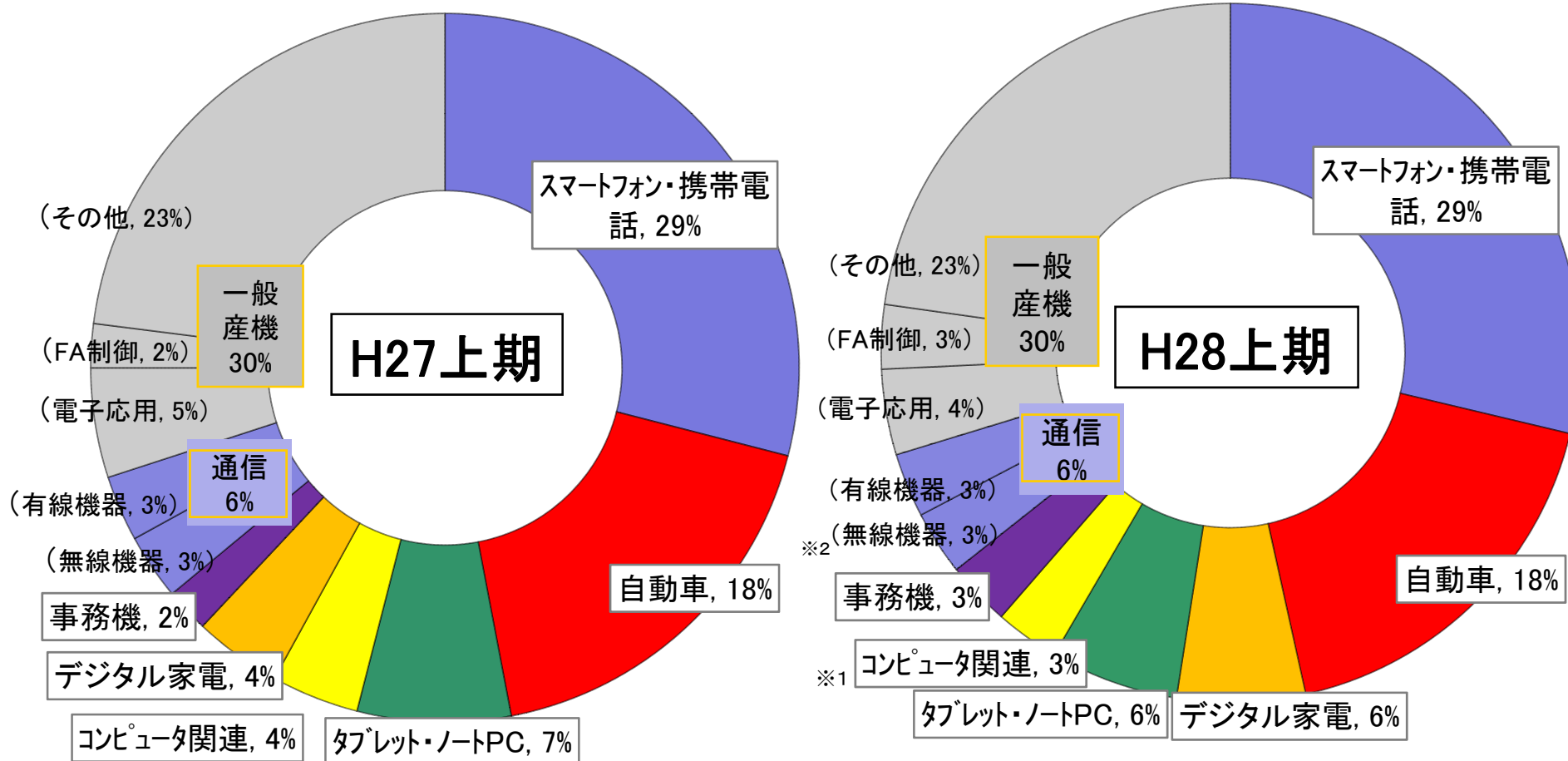
コネクタ用途別売上 前年比較（概数）〔連結ベース〕



〔用途別構成比は概数により実際との誤差の可能性あることをご承知願います。〕

※1 通信機器・・・スマートフォン・携帯電話を除く通信機器
 ※2 コンピュータ関連・・・タブレット・ノートPCを除くコンピュータ関連機器

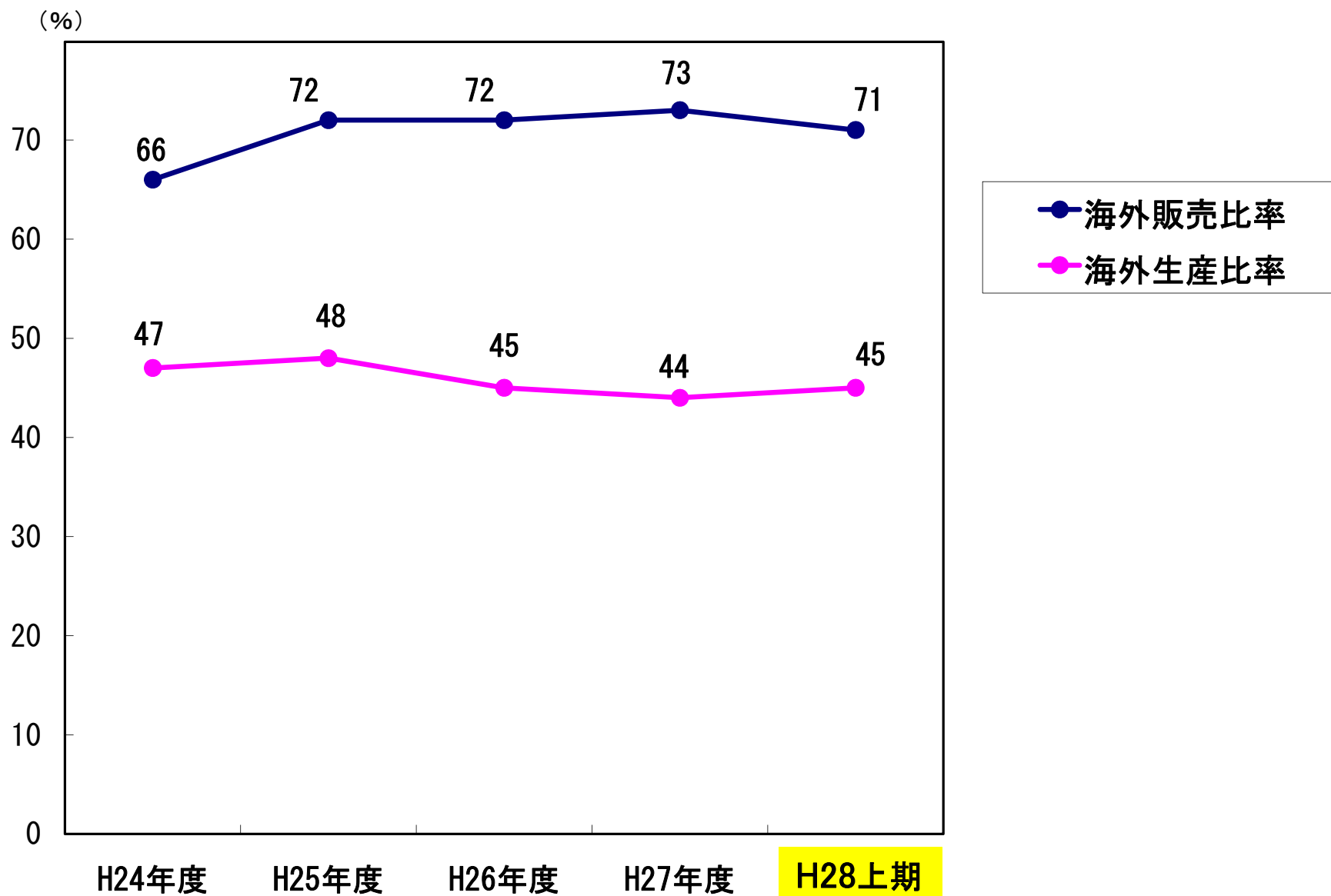
コネクタ用途別売上構成比(概数)〔連結ベース〕



〔用途別構成比は概数により実際との誤差の可能性があるのでご承知願います。〕

※1 コンピュータ関連・・・タブレット・ノートPCを除くコンピュータ関連機器
 ※2 無線機器・・・スマートフォン・携帯電話を除く無線通信機器

海外生産比率・海外販売比率 推移



連結貸借対照表主要増減

(億円)

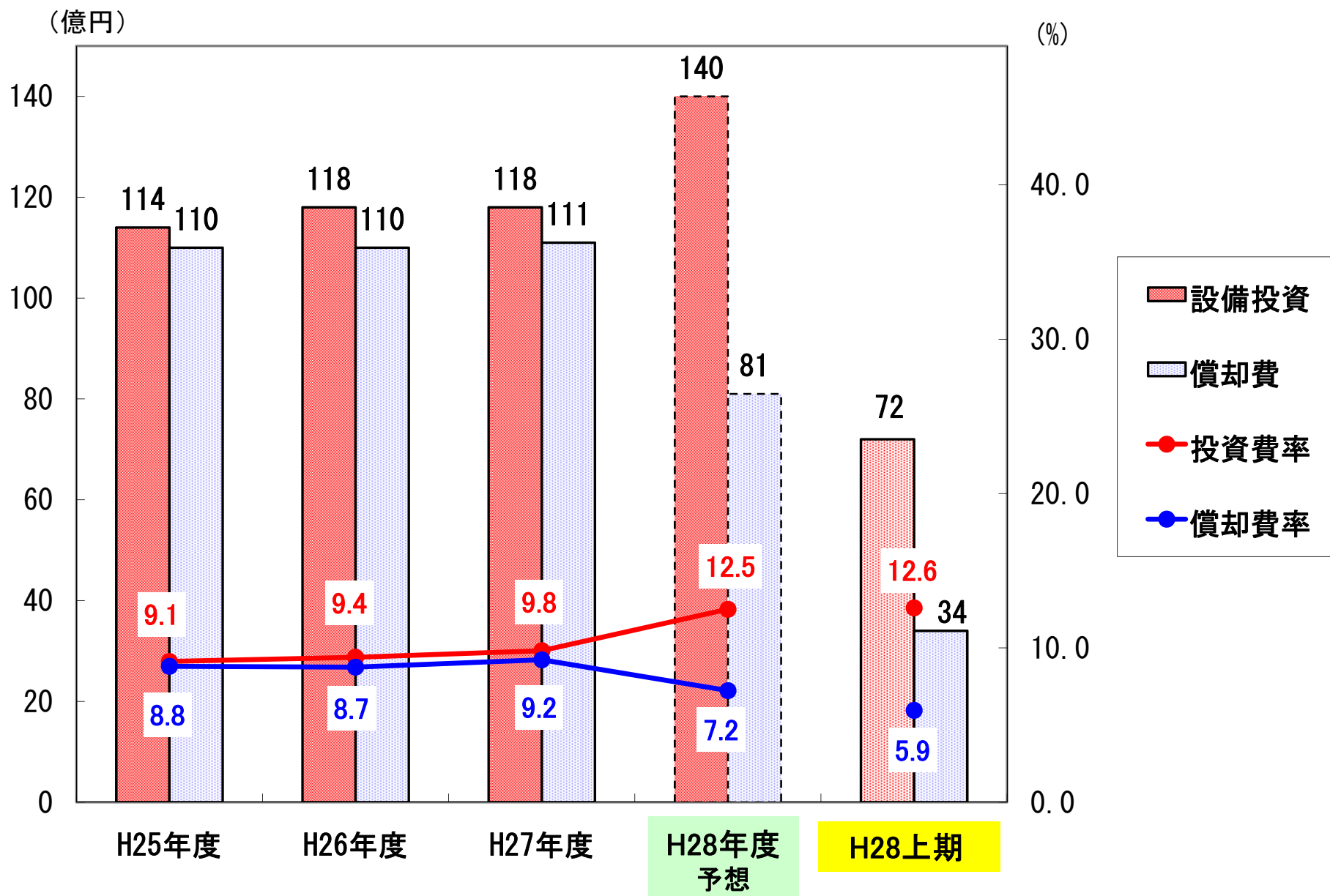
区分	科 目	(A) H28/3末	(B) H28/9末	(B) - (A)	備 考
資	現金及び預金	1,647.5	1,772.6	125.1	国債償還等に伴う増
	受取手形及び 売掛金	273.4	284.6	11.2	9月売上高増に伴う増加
	有価証券	272.1	282.6	10.5	
	棚卸資産	81.5	77.3	-4.2	
産	固定資産	380.4	408.4	28.0	機械装置・金型等増
	投資有価証券	358.7	241.1	-117.6	有価証券（短期）へ振替等
	その他	152.3	96.3	-56.0	
	合 計	3,165.9	3,162.9	-3.0	

連結貸借対照表主要増減

(億円)

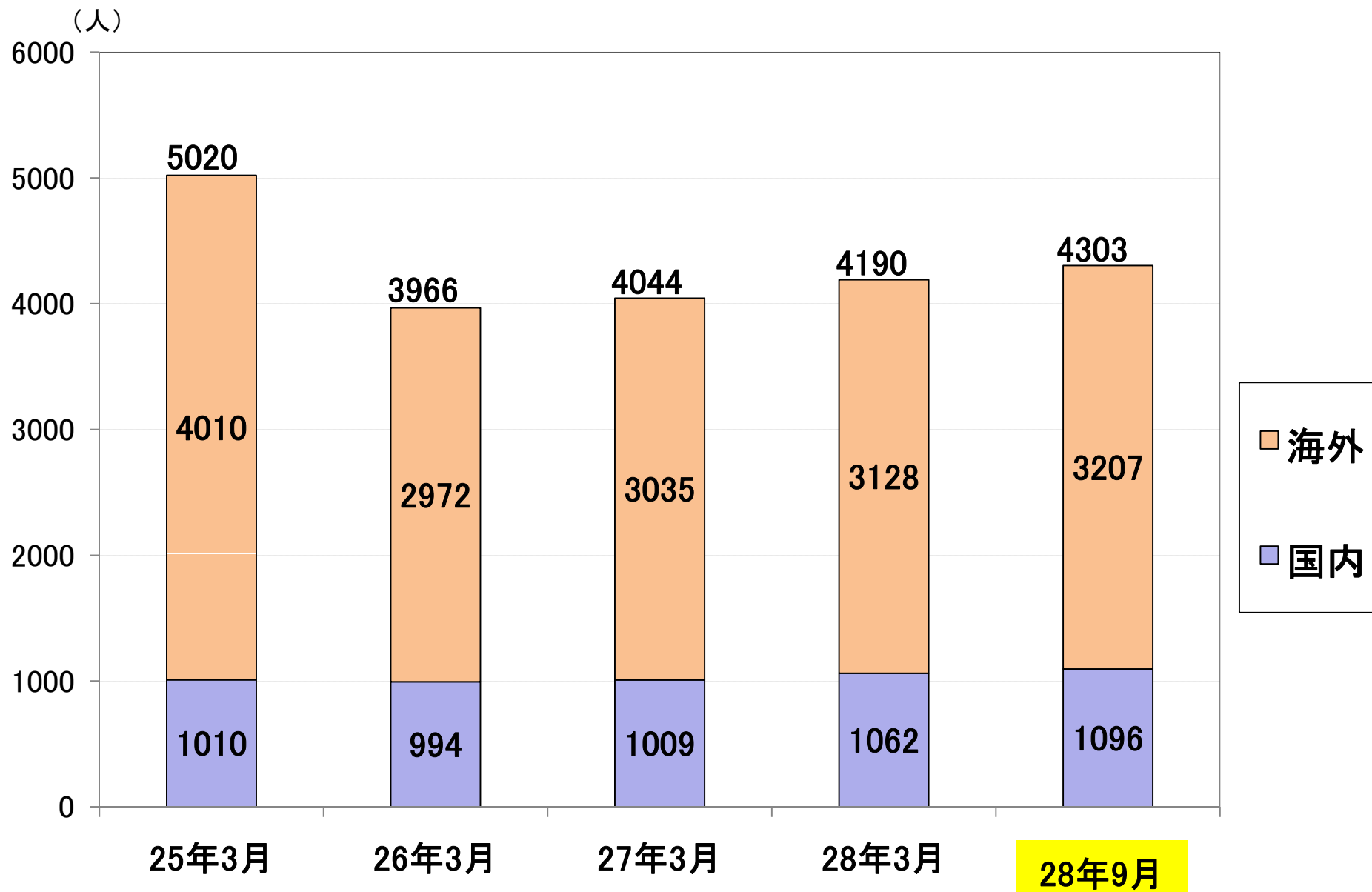
区分	科目	(A) H28/3末	(B) H28/9末	(B) - (A)	備考
負債	支払手形及び買掛金	112.4	111.2	-1.2	
	未払法人税	38.8	42.4	3.6	納税による
	その他	156.4	158.0	1.6	
		307.6	311.6	4.0	
純資産	利益剰余金	3,085.3	3,144.6	59.3	当期純利益101.3億円-配当42.0億円
	自己株式	-564.5	-564.5	0.0	
	その他有価証券	73.4	73.2	-0.2	
	評価差額金				
	為替換算調整勘定	56.9	-10.8	-67.7	円高影響による
その他	207.2	208.8	1.6		
	合計	2,858.3	2,851.3	-7.0	
	負債及び純資産合計	3,165.9	3,162.9	-3.0	

設備投資・償却費 推移（連結ベース）

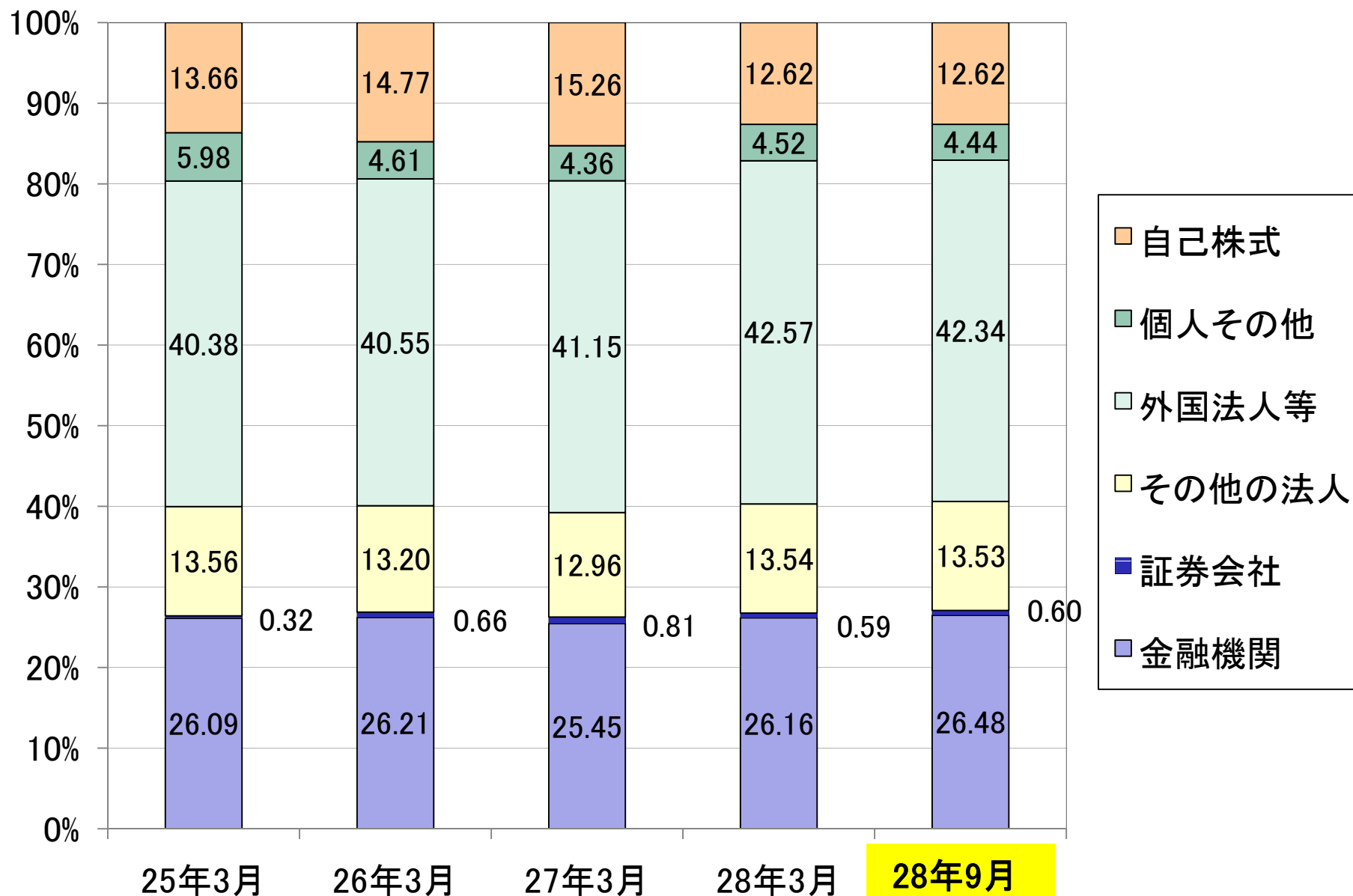


(※除く土地・建物・ソフトウェア投資)

従業員数 推移 (有報ベース)



株式分布推移



H29年3月期 業績予想(連結)

H28/4/28時点の公表値より変更はありません。

第3四半期以降為替レート:1US\$=102.5円(従来105円)、1€=113.5円(従来115円)、100韓国ウォン=9.10円(従来9.20円)

(金額単位:億円)

	H27年度(H28/3月期)実績		H28年度(H29/3月期)予想		第2四半期累計 対前年実績		通期 対前年実績																					
	第2四半期累計	通期	第2四半期累計	通期	増減額	増減率	増減額	増減率																				
売上高 (売上原価率)	612.3 (53.9%)	1,202.8 (54.7%)	571.8 (53.4%)	1,120.0 (53.7%)	-40.5	-6.6%	-82.8	-6.9%																				
営業利益 (%)	152.6 24.9%	287.9 23.9%	142.9 25.0%	270.0 24.1%	-9.7	-6.3%	-17.9	-6.2%																				
経常利益 (%)	167.4 27.3%	305.2 25.4%	143.6 25.1%	280.0 25.0%	-23.8	-14.2%	-25.2	-8.2%																				
当期利益 (%)	116.9 19.1%	211.0 17.5%	101.3 17.7%	195.0 17.4%	-15.6	-13.4%	-16.0	-7.6%																				
一株当り当期利益	-	596.31円	-	557.62円	【年間平均為替レート】																							
一株当り配当	120円	240円	120円	240円	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H27年度実績</th> <th>H28年度予想(今回)</th> <th>H28/7時点</th> <th>H28/4時点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1US\$</td> <td>120.14円</td> <td>103.89円</td> <td>105.79円</td> <td>108.00円</td> </tr> <tr> <td>1€</td> <td>132.58円</td> <td>115.82円</td> <td>116.75円</td> <td>120.00円</td> </tr> <tr> <td>100ウォン</td> <td>10.42円</td> <td>9.16円</td> <td>9.23円</td> <td>9.30円</td> </tr> </tbody> </table>					H27年度実績	H28年度予想(今回)	H28/7時点	H28/4時点	1US\$	120.14円	103.89円	105.79円	108.00円	1€	132.58円	115.82円	116.75円	120.00円	100ウォン	10.42円	9.16円	9.23円	9.30円
	H27年度実績	H28年度予想(今回)	H28/7時点	H28/4時点																								
1US\$	120.14円	103.89円	105.79円	108.00円																								
1€	132.58円	115.82円	116.75円	120.00円																								
100ウォン	10.42円	9.16円	9.23円	9.30円																								
連結配当性向	-	40.2%	-	43.0%																								

中期成長戦略の進捗について

(前回タイトル〈5/10(火)〉: 中期成長戦略の方向性について)

2016, Nov.1st

ヒロセ電機株式会社

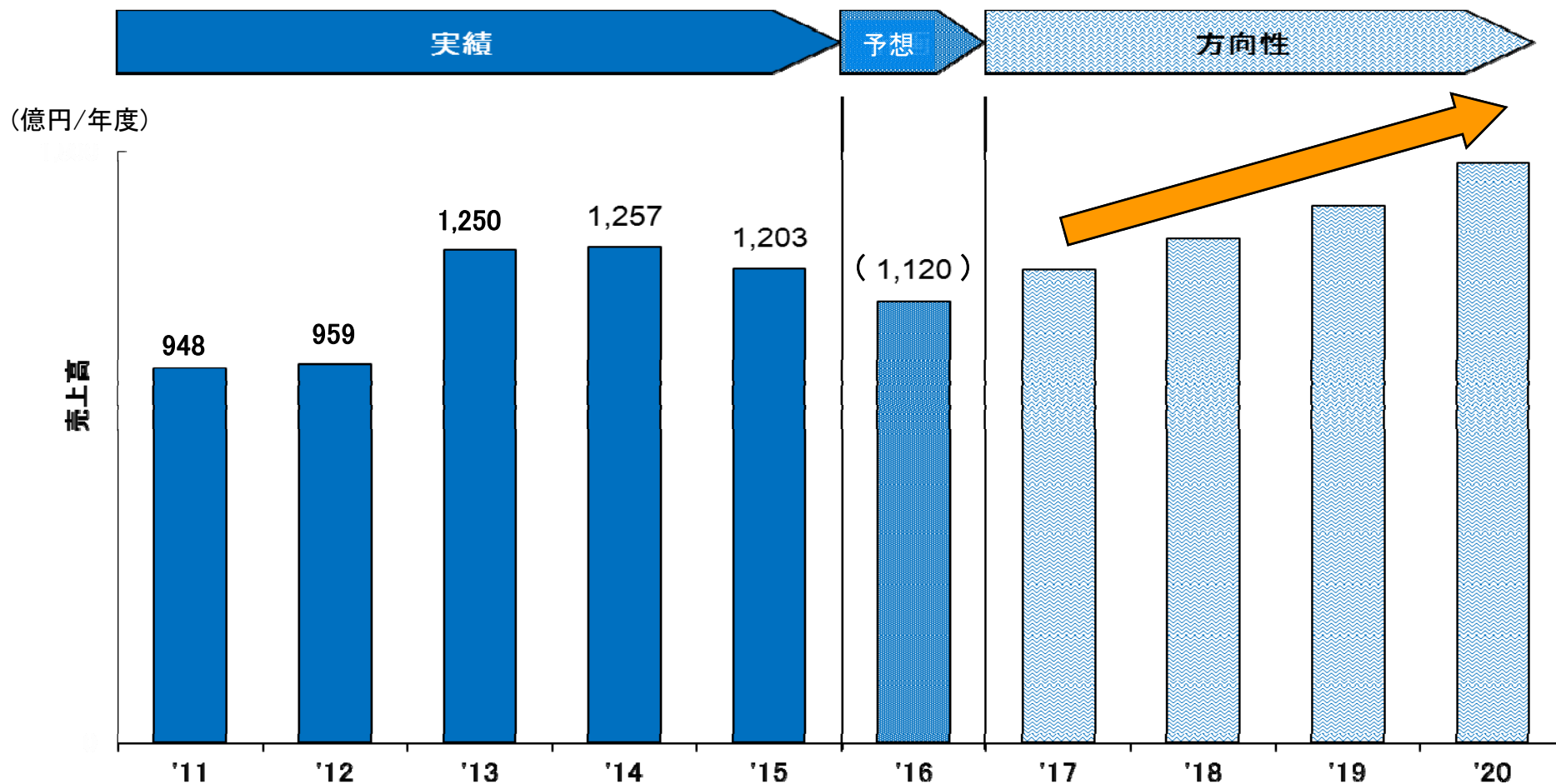
社長 石井 和徳

注意事項

本資料には、ヒロセ電機の現時点における予測に基づく記述が含まれています。

これら将来に関する記述は、既知または未知のリスク及び不確実性その他の要因が内在しており、当社における実際の業績と異なる恐れがあります。ご承知おき下さい。

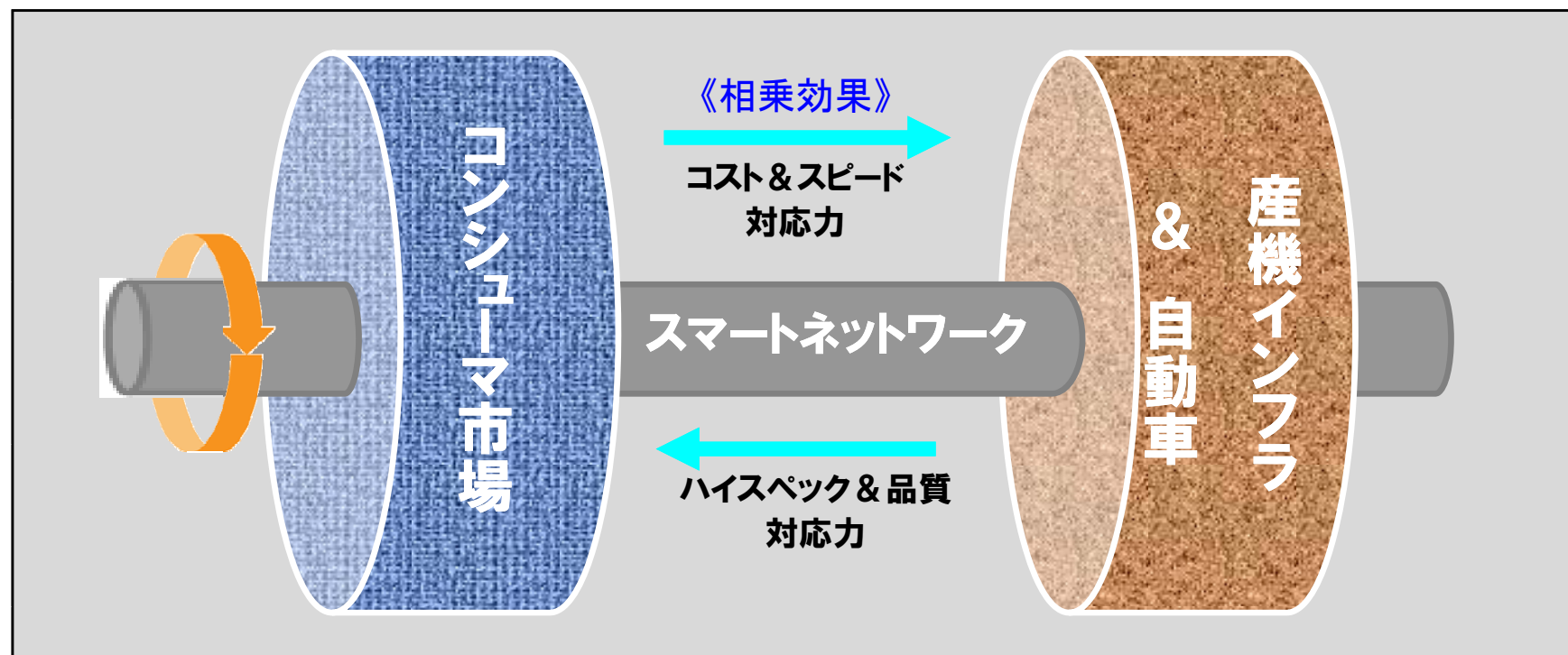
高収益経営を維持し中期的に売上成長



--- → 2016年マイナス成長予想をボトムに価値ある継続成長へ

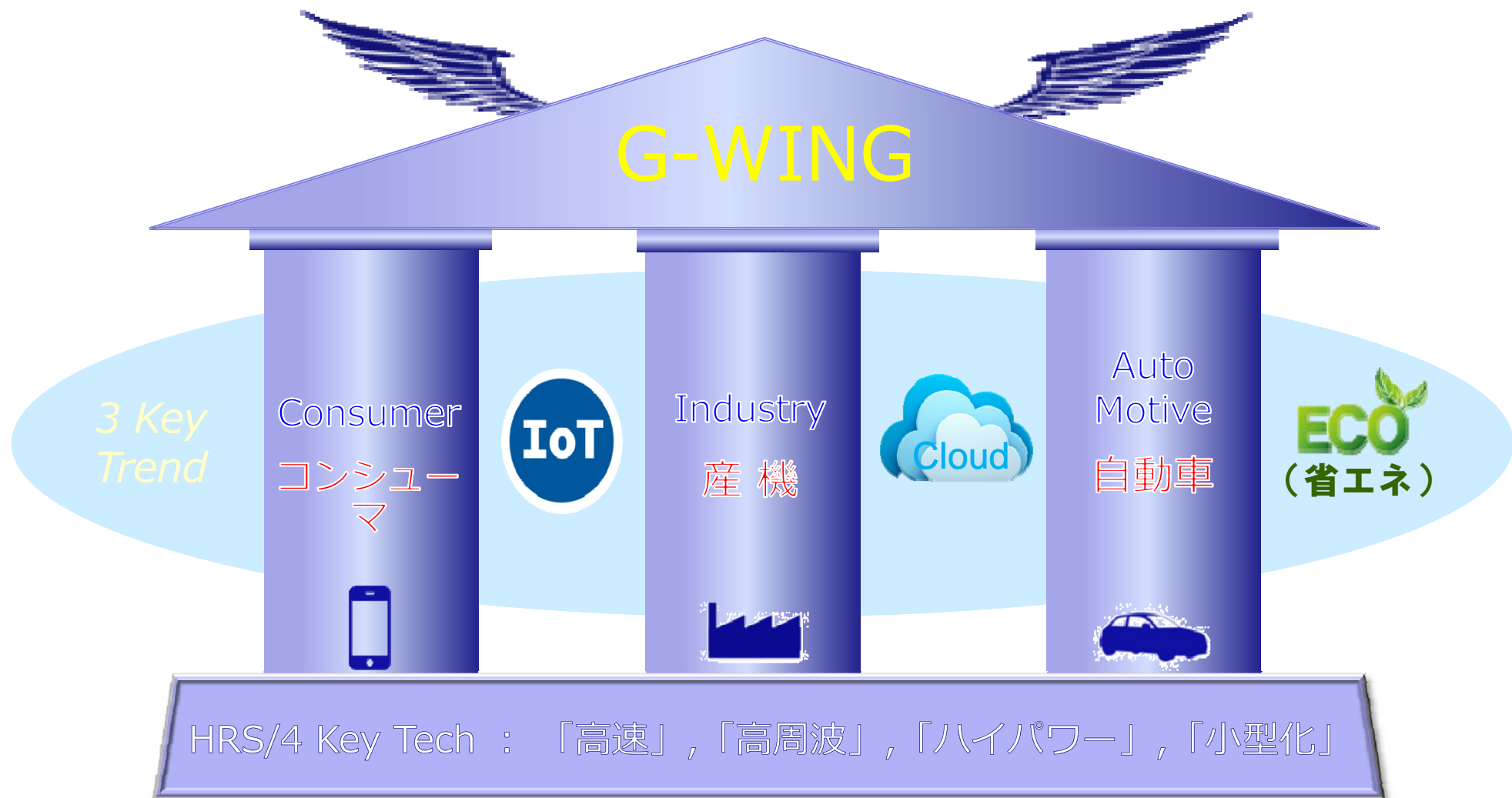
〈プラス〉 為替変動、Global経済不透明感etc. ⇨ 過去の延長でない出来事が続いている

■ 基本的な方向性



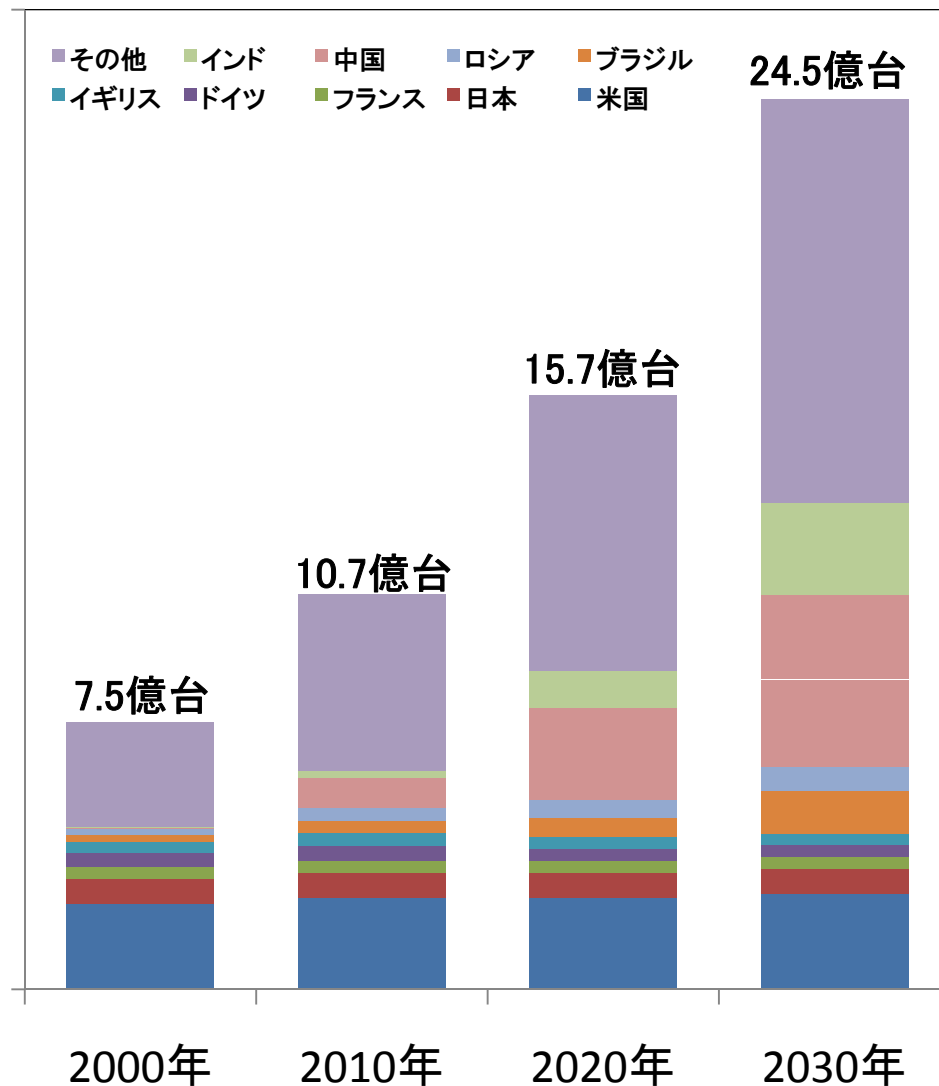
---> [コンシューマ] & [自動車、産機インフラ] の両輪で継続成長!

中期計画 Rev- II

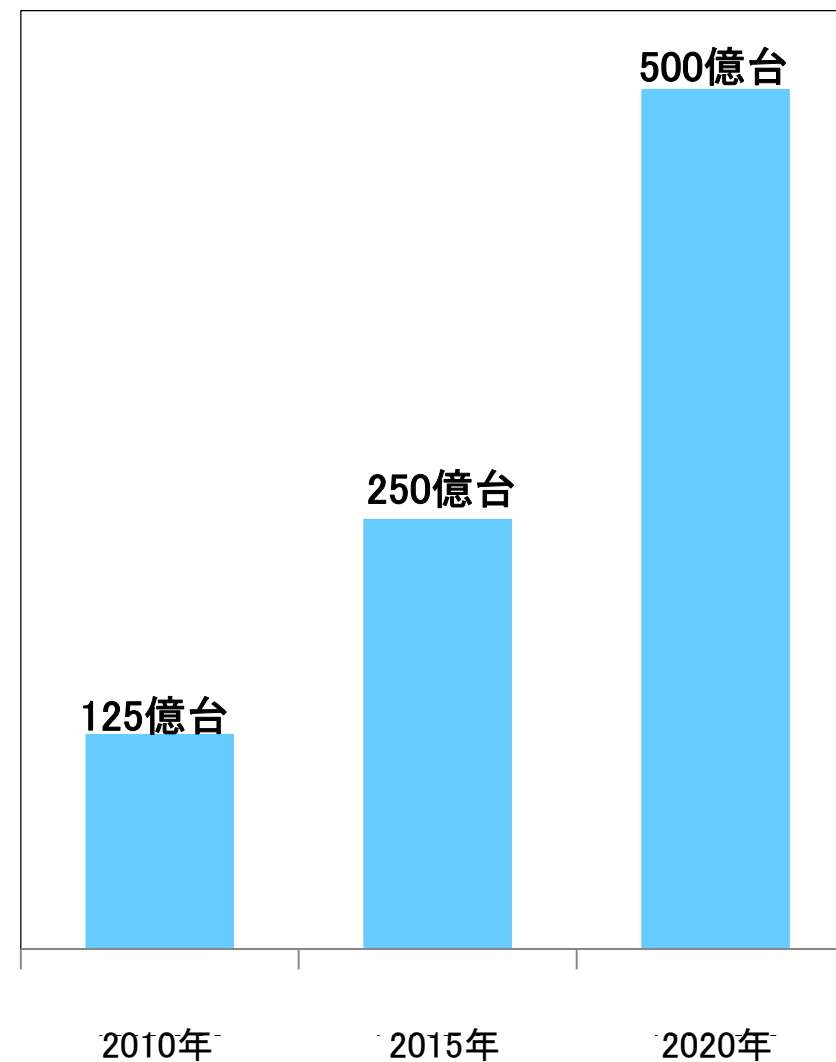


力強い3本柱を形成し、中計G-WINGを達成する

自動車保有台数の推移予測



I o T / I o E デバイス数の推移予測

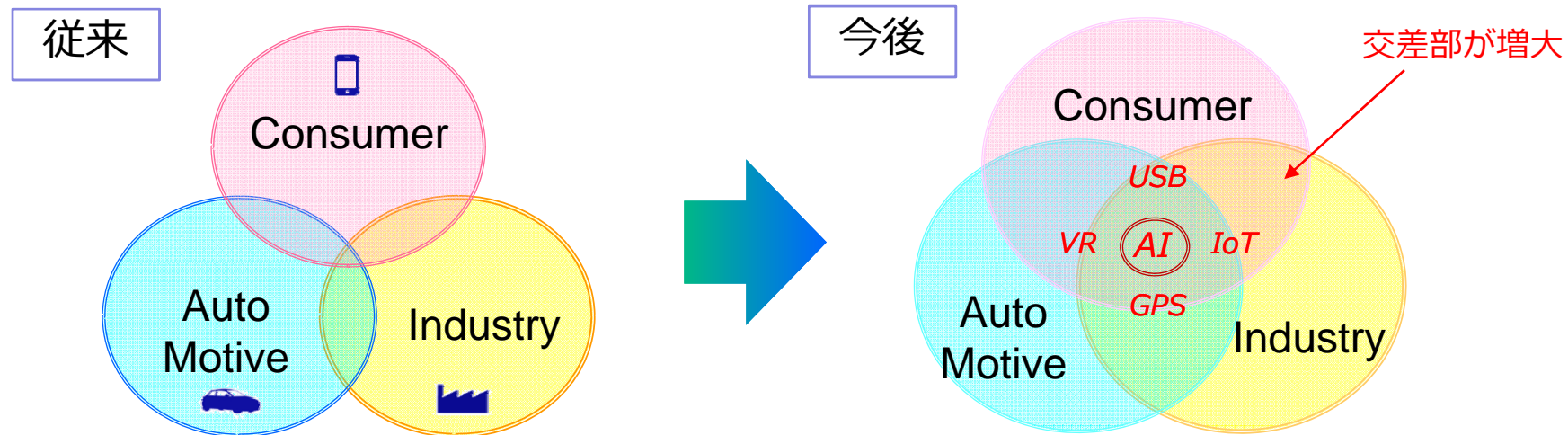


(出所: HRS 推定)

「大きな変化 = 新たなビジネス・チャンス」へ感度アップ

各分野の技術の融合から大競争時代へ

※ 注力する主要3分野の技術融合イメージ



各分野の発展・拡大 ~ 各々で進化した技術が融合 ~ そして更に進化

業界の垣根がどんどん低下 ⇨ 互いの分野への参入が活発化

繋ぐビジネス 拡大への期待感大

分野間連携可能なHRSの強み活かし、各分野で力強い柱を立て安定成長目指す

次世代産機市場向け標準化へのアプローチ（ハーティング社との協業）

□ 市況背景〔IoTに関わるコネクタ変化〕

現在はRJ-45などの従来規格品を利用しているが、あらゆるものが繋がるようになると接続箇所が増え、従来よりも実装密度を上げなければならないため、小型のI/Oコネクタが求められる。



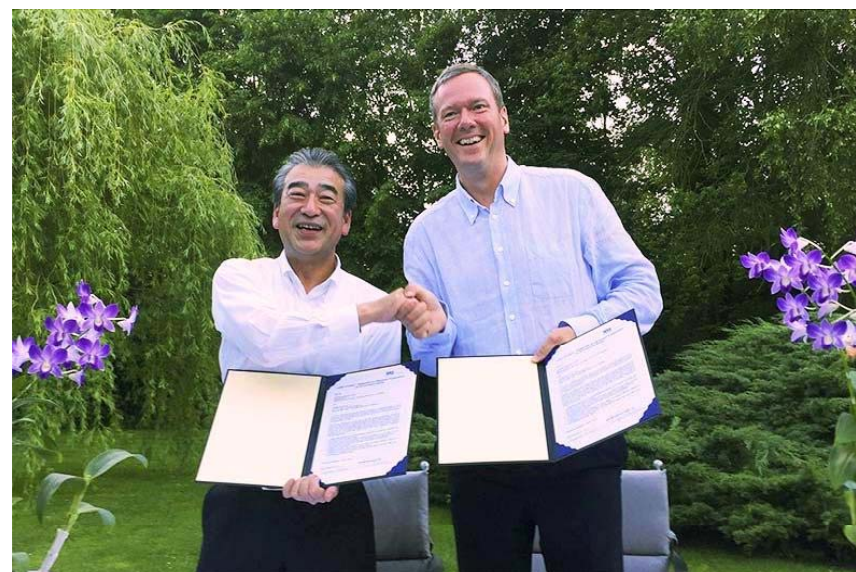
産業機器向け
次世代小型高速伝送用コネクタ

□ 産業機器向けイーサネット接続コネクタの新規格



新しいインダストリー4.0の標準となる
小型で堅牢、高速性能に優れた
10Gbイーサネット向けコネクタを
開発・標準化・マーケティングで協業

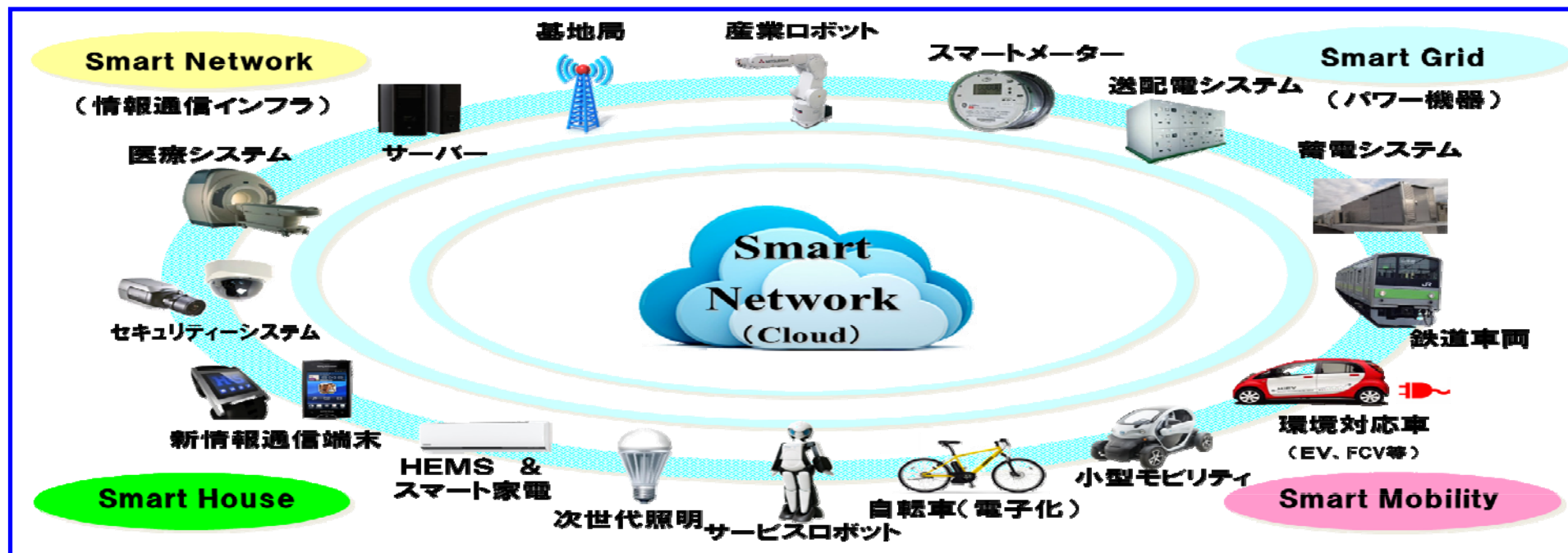
HARTING and Hirose focus on a new standard



HIROSE-President Kazunori Ishii (left) and CEO Philip Harting are looking forward to their future cooperation

(出所: HARTINGホームページ)

4 HRS: 将来への戦略投資について (再掲)



[キートレンド]: 「IoT(全てが繋がる世界)」「クラウドロニクス」「ECO(省電力)」

[キーテクノロジー]: 「高速」、「高周波」、「ハイパワー」、「小型化」への取組み強化

戦略投資

技術開発	工場・設備	ITインフラ
◆高速、高周波伝送技術	◆国内外工場の増強	◆各種基幹システムの強化
◆高電流、耐環境技術	◆超精密加工設備	◆コミュニケーションシステムの充実
◆金型加工技術、めっき技術	◆自動車/産機向け試験・評価設備	◆意思決定支援システムの整備

HIROSE KOREA (新)精密コネクタセンター



2017年1月 稼働予定

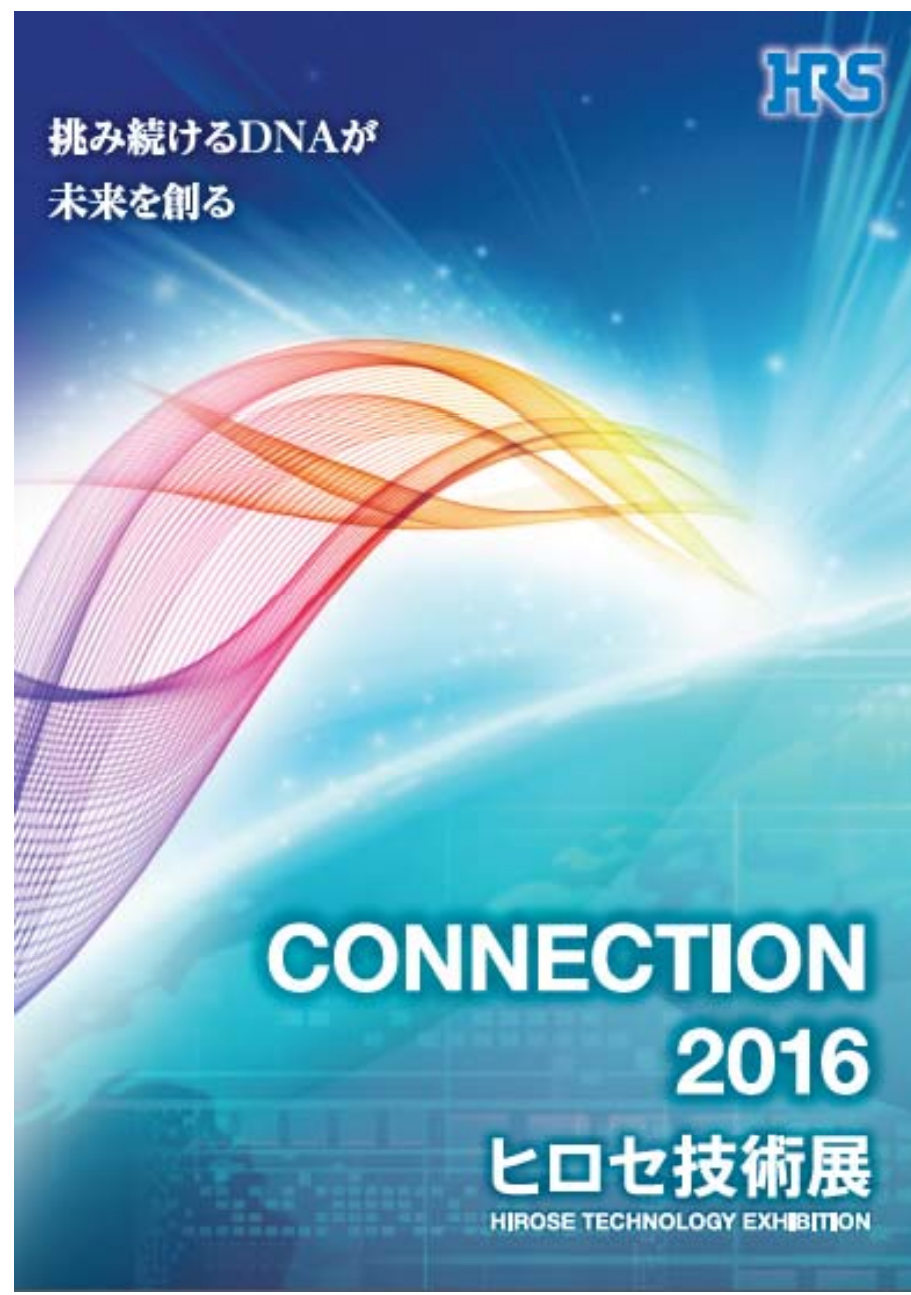


一関 試験センター増築



完成イメージ

2017年度内に稼働予定



C-16 東京会場 のご来場者は
前回(2013年)比 138%
うち 自動車関係では 183%

東京会場:9月15日・16日 大阪会場:11月16日・17日

ごあいさつ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では
第13回ヒロセ技術展 CONNECTION 2016を
開催させて頂く運びとなりましたのでご案内申し上げます。

当日は、各種新製品に加え、弊社の接続技術を駆使した
最先端のご提案品をご紹介致します。
また、「IoTがもたらす変革」についての特別講演や
弊社の最先端技術トレンドについてのセミナーの開催も
予定しております。

3年に1度開催させて頂いております「ヒロセ技術展」に
日頃から格別のご愛顧を賜っております皆様方にぜひ
ご来場いただき、ご高覧願いますよう
宜しくお願い申し上げます。

敬具

平成28年7月吉日

HRS ヒロセ電機株式会社

代表取締役社長 石井 和徳

東京会場 セルリアンタワー東急ホテル



〒150-8512 東京都渋谷区笹丘26-1 TEL:03-3476-3000(代)
渋谷駅西口 歩道横通り 国道246号沿い 徒歩5分 渋谷マークシティより徒歩5分
東急東横線・田園都市線 / 京王井の頭線 / JR山手線・埼京線 /
東京メトロ副都心線・有楽町線・有明線

大阪会場 ハービスHALL



〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 TEL:06-6343-7500(代)
阪神「梅田駅」西改札より徒歩5分 / 阪急「梅田駅」より徒歩約12分
JR「大塚駅」南改札より徒歩約5分 / JR東西線「北新地駅」西改札より徒歩約4分
地下鉄四つ橋線「西梅田駅」北改札より徒歩5分 / 地下鉄御堂筋線「梅田駅」南改札より徒歩約5分
地下鉄谷町線「東梅田駅」北改札より徒歩約5分
※各ターミナルとも地下で連絡
*同会場共にお車でのご来場はご遠慮下さい。

ご招待状

ヒロセ技術展
HIROSE TECHNOLOGY EXHIBITION



**CONNECTION
2016**

TOKYO ▶ 9/15日・16日 **セルリアンタワー東急ホテル**
B2F ホールルーム 開催時間: [9/15] 10:00-18:00 [9/16] 9:00-18:00
OSAKA ▶ 11/16日・17日 **ハービスHALL**
B2F ハービスHALL 開催時間: [11/16] 10:00-18:00 [11/17] 9:00-18:00
協賛: 豊田通商株式会社、タイトエレクトロニクス株式会社、大成建設株式会社、
同本株式会社、太平洋電機株式会社、スズデン株式会社

技術展を通して「お客様の声をキャッチング」⇨未来プロダクトへの展開を加速